

# 高機能 多層FR-4.0プリント配線板

## ■高信頼性・高Tgタイプ

基材種類...R-1755S (パナソニック(株)製)

内層銅箔...35, 70 $\mu$ m

外層銅箔...18, 35, 70 $\mu$ m

## ■高信頼性・耐トラッキングタイプ

基材種類...L-6554C (ニッカン工業(株)製)

内層銅箔...35,70,105,140,175,210 $\mu$ m

外層銅箔...18, 35, 70 $\mu$ m

項目	条件	単位	実測値	
			R-1755S	L-6554C
Tg	TMA	°C	170	130
CTE	XY<Tg	ppm/°C	12	16
	XY>Tg		14	12
	Z<Tg		50	35
	Z>Tg		255	230
誘電率	1GHz	—	4.4	4.9
誘電正接	1GHz	—	0.016	0.015
吸水率	JIS法	%	0.05	0.04
耐難燃性	UL94V	—	94V-0	94V-0
耐トラッキング性	IEC法	V	175~250	>600

cgk

株式会社ちの技研

ISO9001  
認証

ISO14001  
認証